



Regeling van de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van 20 november 2025, nr. BZ2520952, houdende intrekking van de Regeling aanvullende controlemaatregelen op de Verordening producten voor tweeeërlei gebruik en de wijziging van de Regeling geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 9 van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2021 tot instelling van een Unieregeling voor controle op de uitvoer, de tussenhandel, de technische bijstand, de doorvoer en de overbrenging van producten voor tweeeërlei gebruik, artikel 2, vijfde lid, van de Wet strategische diensten en artikel 4 van het Besluit strategische goederen;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling aanvullende controlemaatregelen op de Verordening producten voor tweeeërlei gebruik wordt ingetrokken.

ARTIKEL II

De bijlage behorende bij de Regeling geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders wordt vervangen door de bijlage bij deze regeling.

ARTIKEL III OVERGANGSRECHT

1. Vergunningen die voor 15 november 2025 zijn verleend op grond van artikel 2 van de Regeling aanvullende controlemaatregelen op de Verordening producten voor tweeeërlei gebruik, berusten gedurende de resterende looptijd van de vergunning na de inwerkingtreding van deze regeling op artikel 12 van de Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2021 tot instelling van een Unieregeling voor controle op de uitvoer, de tussenhandel, de technische bijstand, de doorvoer en de overbrenging van producten voor tweeeërlei gebruik.
2. Vergunningen die voor 15 november 2025 zijn verleend op grond van artikel 2 van de Regeling geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders, en die betrekking hebben op geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders die niet wordt genoemd in de bijlage bij Regeling geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders, behorende bij de bijlage van deze regeling, berusten gedurende de resterende looptijd van de vergunning na de inwerkingtreding van deze regeling op artikel 12 van de Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2021 tot instelling van een Unieregeling voor controle op de uitvoer, de tussenhandel, de technische bijstand, de doorvoer en de overbrenging van producten voor tweeeërlei gebruik,
3. De SG-code van een vergunning, bedoeld in het eerste of tweede lid, wordt overeenkomstig de tabel in de bijlage bij deze regeling gewijzigd in de SG-code, genoemd in bijlage I van de Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2021 tot instelling van een Unieregeling voor controle op de uitvoer, de tussenhandel, de technische bijstand, de doorvoer en de overbrenging van producten voor tweeeërlei gebruik.

ARTIKEL IV

Deze regeling treedt in werking met ingang van 15 november 2025. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 14 november 2025 treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 15 november 2025.



Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

*De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,
A. de Vries*



BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL II VAN REGELING VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN VAN 20 NOVEMBER 2025, NR. BZ2520952, HOUDENDE INTREKKING VAN DE REGELING AANVULLENDE CONTROLEMAATREGELEN OP DE VERORDENING PRODUCTEN VOOR TWEEËRLEI GEBRUIK EN DE WIJZIGING VAN DE REGELING GEAVANCEERDE PRODUCTIEAPPARATUUR VOOR HALFGELEIDERS (STCRT. 2025, 38653)

BIJLAGE BEHORENDE BIJ DE REGELING GEAVANCEERDE PRODUCTIEAPPARATUUR VOOR HALFGELEIDERS

Algemene noten, acroniemen, afkortingen en definities in bijlage I behorende bij de Verordening producten voor tweeërlei gebruik zijn van overeenkomstige toepassing op deze bijlage.

3B8 Test-, inspectie- en productieapparatuur

3B801 'Productieapparatuur', 'programmatuur' en 'technologie' voor halfgeleiderelementen of materialen, niet gecontroleerd onder 3B001, 3D001, 3D002 en 3E001 van bijlage I bij de Verordening producten voor tweeërlei gebruik, als hieronder, en speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren daarvoor:

- 3B801 c. Apparatuur voor schoonmaken of verwijderen, als hieronder:
1. Apparatuur ontworpen voor het verwijderen van polymeerresiduen en koperoxidelagen ter voorbereiding voor het afzetten van een kopermetaal in een vacuümomgeving (gelijk aan of lager dan 0,01 Pa).
 2. Apparatuur ontworpen voor de droge verwijdering van oxides van oppervlakken of de droge verwijdering van vervuiling op oppervlakken, gebruik makend van meerdere kamers of meerdere stations.

Noot: 1. Controle 3B801.c geldt niet voor apparatuur om lagen af te zetten.

- 3B801 d. Apparatuur voor afzetting, als hieronder:

- 3B801 d. 3. Apparatuur ontworpen voor atomaire-lagen-afzetting (ALD) van Molybdeen (Mo), Ruthenium (Ru) of combinaties van beide materialen, met alle van de volgende eigenschappen:
- a. Een metaalbron voor uitgangsstof (<precursor>) ontworpen of aangepast voor temperaturen hoger dan 75°C; en
 - b. Een kamer (module) waar gebruik gemaakt kan worden van een reductiemiddel dat waterstof bevat, op een druk groter of gelijk aan 30 Torr (4kPa).

Noot: 1. De bron voor metaal-uitgangsstof (<precursor>) hoeft niet geïntegreerd te zijn in de apparatuur.

- 3B801 d. 4. Apparatuur ontworpen voor afzetten van een diëlectrische laag middels plasma versterkte chemische-lagen-afzetting (PECVD) of chemische lagen afzetting met behulp van vrije radicalen en UV behandeling in één platform, terwijl de substraattemperatuur lager gehouden wordt dan 500°C, met alle van de volgende eigenschappen:
- a. Een laagdikte tussen de 6 en 20 nm op metalen 'gaten' met een 'diepte/hoogteverhouding' (<aspect ratio>) gelijk of groter dan 1:1,8 en een breedte van minder dan 24 nm; en
 - b. Een diëlectrische constante van minder dan 3,0

Technische noten:

1. 'Gaten' is de ruimte tussen de metalen lijnen.

2. 'Diepte/hoogteverhouding' is de verhouding tussen de hoogte en diepte van het gat tussen de metalen lijnen.

- 3B801 d. 5. Apparatuur voor het afzetten van lagen, gebruikmakend van directe vloeistofinjectie van meer dan twee metalen uitgangsstoffen (<precursors>), ontworpen of aangepast voor het aanbrengen van een conforme diëlectrische laag met een diëlectrische constante (K) groter dan 40 in 'gaten' met een 'diepte/hoogteverhouding' (<aspect ratio>) gelijk of groter dan 200:1 in een en dezelfde depositie kamer.

Technische noten:

1. 'Gaten' is de ruimte tussen de metalen lijnen.

2. 'Diepte/hoogteverhouding' is de verhouding tussen de hoogte en diepte van het gat tussen de metalen lijnen.

- 3B801 d. 6. Apparatuur voor het afzetten van lagen, gebruikmakend van directe vloeistofinjectie van meer dan twee metalen uitgangsstoffen (<precursors>), ontworpen of aangepast voor het aanbrengen van een conforme diëlectrische laag met een diëlectrische constante (K) groter dan 35 in 'gaten' met een 'diepte/hoogteverhouding' (<aspect ratio>) gelijk of groter dan 50:1 in een en dezelfde depositie kamer.

Technische noten:

1. 'Gaten' is de ruimte tussen de metalen lijnen.

2. 'Diepte/hoogteverhouding' is de verhouding tussen de hoogte en diepte van het gat tussen de metalen lijnen.

- 3B801 d. 7. Apparatuur of systemen voor de productie van halfgeleiders ontworpen voor in meerdere stappen bewerken van wafers in meerdere kamers of stations, met één van de volgende eigenschappen:
- Selectieve groei van Tungsten (W) zonder barrière laag; of
 - Selectieve groei van Molybdenum (Mo) zonder barrière laag
- 3B801 d. 8. Apparatuur ontworpen voor het middels op afstand gegenereerde vrije radicalen afzetten van een laag die silicium en koolstof bevat, met alle van de volgende eigenschappen van de afgezette laag:
- In 'gaten' met een 'diepte/hoogteverhouding' (<aspect ratio>) groter dan 5:1 en een laterale breedte van minder dan 35 nm;
 - Een diëlectrische constante (K) van minder dan 4,4; en
 - Een afstand tussen twee 'gaten' van minder dan 45 nm.
- Technische noten:*
- 'Gaten' is de ruimte tussen de metalen lijnen.
 - 'Diepte/hoogteverhouding' is de verhouding tussen de hoogte en diepte van het gat tussen de metalen lijnen.
- 3B801 d. 9. Apparatuur, niet beschreven door 3B801.d.8, ontworpen voor het middels op afstand gegenereerde vrije radicalen afzetten van een laag die silicium en koolstof bevat, met alle van de volgende eigenschappen van de afgezette laag:
- In 'gaten' met een 'diepte/hoogteverhouding' (<aspect ratio>) groter dan 5:1 en een laterale breedte van minder dan 70 nm;
 - Een diëlectrische constante (K) van minder dan 5,3; en
 - Een afstand tussen twee 'gaten' van minder dan 100 nm.
- Technische noten:*
- 'Gaten' is de ruimte tussen de metalen lijnen.
 - 'Diepte/hoogteverhouding' is de verhouding tussen de hoogte en diepte van het gat tussen de metalen lijnen.
- 3B801 f. Lithografische apparatuur, als hieronder:
- 3B801 f. 6. Repeteerapparatuur ('step and repeat' ('direct step on wafer') apparatuur of 'step and scan' (scanner) apparatuur) voor uitrichten en belichten ten behoeve van het bewerken van wafers, waarbij gebruik wordt gemaakt van foto-optische of röntgenmethoden, met alle van de volgende eigenschappen:
- een golflengte van de lichtbron gelijk aan of groter dan 193 nm;
 - in staat om patronen te produceren met een 'minimum resolvable feature size' (MRF) van 45 nm of minder; en
 - een maximale 'dedicated chuck overlay' (DCO) waarde hoger dan 1,50 nm en kleiner dan of gelijk aan 2,40 nm.
- Technische noten:*
- De 'minimum resolvable feature size' (MRF) wordt berekend volgens de volgende formule:
$$MRF = \frac{(\text{golflengte van de lichtbron in nm}) \times (K \text{ factor})}{\text{maximale numerieke apertuur}}$$
- waarbij de K-factor = 0,25
(MRF) is zelfde als resolutie.
- DCO is de mate van accuraatheid van uitlijning van een nieuw patroon op een bestaand patroon belicht op een wafer door hetzelfde lithografische systeem.
- 3B801 f. 7. Apparatuur, niet beschreven door controle 3B801.f.6 of 3B501.f.1.b. van Bijlage I van de Verordening producten voor tweërlei gebruik, ontworpen of aangepast om het aantal verwerkte wafers per uur te verhogen met minstens 1% over een ieder tijdsinterval, voor apparatuur gespecificeerd in 3B801.f.6 of 3B501.f.1.b. van Bijlage I van de Verordening producten voor tweërlei gebruik.
- 3B802 Testapparatuur voor het testen van halfgeleiderelementen, als hieronder:
- c. Metrologie- of inspectieapparatuur, als hieronder:
- Systemen voor het vinden of inspecteren van defecten op wafers met een daarop aangebracht patroon, ontworpen of aangepast voor wafers groter of gelijk aan 300mm in diameter, met alle van de volgende eigenschappen:
 - Ontworpen of aangepast om defecten te vinden met een afmeting kleiner of gelijk aan 21 nm; en
 - Gebruik makend van ten minste één van de volgende technologieën:
 - Een lichtbron met golflengte kleiner dan 400 nm;
 - Een elektronenbundel met een resolutie kleiner (beter) dan of gelijk aan 1,65 nm;
 - Een koude veldemissie (<Cold Field Emission>) elektronenbundelbron;
 - Twee of meerdere elektronenbundelbronnen.
 - Systemen ontworpen om uitlijning of focus te meten van productiewafers na het ontwikkelen van fotolak of na etsen, gebruik makend van op afbeelding gebaseerde uitlijning of van op diffractie gebaseerde meetmethoden, met nauwkeurigheid van de meting van de uitlijning kleiner (beter) of gelijk aan 0,5nm en één van de volgende eigenschappen:
 - Ontworpen voor integratie in een 'track'.
 - Gebruik makend van functionaliteit voor snelle golflengte wisseling (<fast wavelength switching>).



Technische noten:

1. Een track is apparatuur ontworpen voor het aanbrengen van een laag en het ontwikkelen van fotolak voor lithografieapparatuur.

2. Onder snelle golflengte wisseling wordt verstaan dat binnen 25 ms de golflengte gewisseld kan worden en een meting gedaan kan worden.

3D8 Programmatuur

- 3D806 'Programmatuur' speciaal ontworpen voor de 'ontwikkeling', de 'productie' of het 'gebruik' van de apparatuur die is vermeld in deze regeling onder post 3B801.f.6.
- 3D807 'Programmatuur' speciaal ontworpen voor de 'ontwikkeling', de 'productie' of het 'gebruik' van de apparatuur die is vermeld in deze regeling onder post 3B801.d.3, 3B801.d.4, 3B801.d.5, 3B801.d.7, 3B801.d.8.
- 3D808 'Programmatuur' speciaal ontworpen voor de 'ontwikkeling', de 'productie' of het 'gebruik' van de apparatuur die is vermeld in deze regeling onder post 3B801.d.6, 3B801.d.9, 3B801.c.1 of 3B801.c.2.
- 3D809 Programmatuur voor rekenkundig optimaliseren van lithografie (<Computational Lithography>), ontworpen of aangepast voor de ontwikkeling of productie van patronen op diep ultraviolette (DUV) lithografie maskers.

Technische noot:

1. Rekenkundig optimaliseren van lithografie is het gebruik van computermodellen om de prestatie van een lithografie-proces te voorspellen, verbeteren en optimaliseren over een bereik van patronen, processen en systeemcondities.

3E8 Technologie

- 3E806 'Technologie' die 'noodzakelijk' is voor de 'ontwikkeling', 'productie' of het 'gebruik' van apparatuur, vermeld in deze regeling onder post 3B801.f.6.
- 3E807 'Technologie' die 'noodzakelijk' is voor de 'ontwikkeling', 'productie' of het 'gebruik' van apparatuur, vermeld in deze regeling onder post 3B801.d.3, 3B801.d.4, 3B801.d.5, 3B801.d.7, 3B801.d.8.
- 3E808 'Technologie' die 'noodzakelijk' is voor de 'ontwikkeling', 'productie' of het 'gebruik' van apparatuur, vermeld in deze regeling onder post 3B801.d.6, 3B801.d.9, 3B801.c.1 of 3B801.c.2.



BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL III, DERDE LID, VAN DE REGELING VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN VAN 20 NOVEMBER 2025, NR. BZ2520952, HOUDENDE INTREKKING VAN DE REGELING AANVULLENDE CONTROLEMAATREGELEN OP DE VERORDENING PRODUCTEN VOOR TWEEËRLEI GEBRUIK EN DE WIJZIGING VAN DE REGELING GEAVANCEERDE PRODUCTIEAPPARATUUR VOOR HALFGELEIDERS (STCRT. 2025, 38653)

SG-code verleende vergunning o.g.v. de Regeling aanvullende controlemaatregelen op de Verordening producten voor tweeërlei gebruik	SG-code, genoemd in de Verordening producten voor tweeërlei gebruik
2B910	2B510
2D901	2D001
2E901	2E001
2E902	2E002
2E903.g.	2E503.g.
3A901.a.15.	3A501.a.15.
3A901.a.16.	3A501.a.16.
3A901.b.13.	3A501.b.13.
3A904	3A504
3B901.k.	3B501.k.
3B901.l.	3B501.l.
3B903	3B503
3B904	3B504
3C907	3C507
3C908	3C508
3C909	3C509
3D901	3D001
3D902	3D002
3D907	3D507
3E901	3E001
3E905	3E505
4A906	4A506
4A907	4A507
4D901.b.3.	4D001.b.3.
4E901.b.3.	4E001.b.3.
SG-code verleende vergunning o.g.v. de Regeling geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders	
3B801.a.4.	3B501.a.4.
3B801.d.1.	3B501.n.1.c.
3B801.d.2.	3B501.n.5.
3B801.f.5.	3B501.f.1.b.
3B801.l.	3B501.m.
3D805	3D001 en 3D002
3E805	3E001
3E807	3E001



TOELICHTING

I Algemeen

1. Inleiding

De uitvoer van goederen en technologie voor tweeeërlei gebruik naar bestemmingen buiten de EU is gereguleerd in Verordening (EU) 2021/821 van het Europees parlement en de Raad van 20 mei 2021 tot instelling van een Unieregeling voor controle op de uitvoer, de tussenhandel, de technische bijstand, de doorvoer en de overbrenging van producten voor tweeeërlei gebruik¹ (hierna: de Verordening producten voor tweeeërlei gebruik).

Op grond van artikel 4 van het Besluit strategische goederen (hierna: het besluit), dat gebaseerd is op de ruimte die artikel 9 van de Verordening producten voor tweeeërlei gebruik hiertoe biedt, heeft de Staatssecretaris Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp de bevoegdheid om redenen van openbare veiligheid, waaronder het voorkomen van terreurdaden, of uit mensenrechtenoverwegingen een verbod in te stellen op, of een vergunning verplicht te stellen voor de uitvoer van goederen voor tweeeërlei gebruik die niet zijn genoemd in bijlage I van de Verordening producten voor tweeeërlei gebruik.

In de Regeling aanvullende controlemaatregelen op de Verordening producten voor tweeeërlei gebruik en de Regeling geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders is voor diverse goederen en technologie voor tweeeërlei gebruik een vergunningplicht opgelegd omdat de ongecontroleerde uitvoer ervan risico's voor de openbare veiligheid kan meebrengen.

De Europese Commissie is op grond van artikel 17 van de Verordening producten voor tweeeërlei gebruik bevoegd om overeenkomstig artikel 18 van de verordening gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde de bijlagen van de Verordening te wijzigen. Op 8 september 2025 heeft de Europese Commissie een gedelegeerde verordening (hierna: de gedelegeerde verordening) vastgesteld teneinde de lijst van producten voor tweeeërlei gebruik te wijzigen.²

Deze gedelegeerde verordening heeft grotendeels betrekking op producten die in Nederland reeds worden gecontroleerd via de Regeling aanvullende controlemaatregelen op de Verordening producten voor tweeeërlei gebruik en de Regeling geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders. Dat heeft tot gevolg dat deze regelingen moeten worden ingetrokken respectievelijk gewijzigd.

De Regeling aanvullende controlemaatregelen op de Verordening producten voor tweeeërlei gebruik wordt in zijn geheel ingetrokken, omdat alle producten in deze regeling via de gedelegeerde verordening zijn opgenomen in Bijlage I van de Verordening producten voor tweeeërlei gebruik. De Regeling geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders wordt gewijzigd, omdat een deel van de producten in deze regeling via de gedelegeerde verordening zijn opgenomen in Bijlage I van de Verordening producten voor tweeeërlei gebruik. Hiertoe wordt de bijlage van deze regeling vervangen door een nieuwe bijlage.

2. Gevolgen (administratieve lasten)

De gedelegeerde verordening voegt een aantal producten toe aan Bijlage I van de Verordening producten tweeeërlei gebruik. Het gaat grotendeels om producten die reeds vergunningplichtig waren op grond van de Regeling aanvullende controlemaatregelen op de Verordening producten voor tweeeërlei gebruik en de Regeling geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders. De vergunningen die bedrijven hadden op grond van deze regelingen, worden door de Douane ambtshalve vervangen door vergunningen op grond van de Verordening producten voor tweeeërlei gebruik. De betrokken bedrijven verwerken zo nodig deze nieuwe vergunningen in hun eigen systemen. De Regeling heeft daarom geen gevolgen voor de administratieve lasten van bedrijven. Er zijn twee producten die niet onder controle vielen op basis van de eerdergenoemde regelingen. Het is niet bekend dat er bedrijven in Nederland zijn die deze producten produceren of uitvoeren.

Het ATR heeft het dossier niet geselecteerd voor een formeel advies, omdat het geen gevolgen voor de regeldruk heeft.

¹ PbEU 2021, L 206

² Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/2003 van de Commissie van 8 september 2025 tot wijziging van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees parlement en de Raad wat betreft de lijst van producten voor tweeeërlei gebruik.

3. Uitvoering

De onderhavige Regeling heeft slechts beperkte gevolgen voor de uitvoering. De Douane is belast met het uitvoeren van het Besluit strategische goederen, dat de noodzakelijke uitvoering geeft aan de Verordening producten voor tweeeërlei gebruik. Omdat de gedelegeerde verordening de reikwijdte van de gecontroleerde producten niet wijzigt, zou dit niet moeten leiden tot hogere lasten voor de uitvoering. Het is wel noodzakelijk om de afgegeven vergunningen op grond van de Regeling aanvullende controlemaatregelen op de Verordening producten voor tweeeërlei gebruik en de Regeling geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders in lijn te brengen met de nieuwe realiteit, namelijk controle via de Verordening producten voor tweeeërlei gebruik. Hiertoe heeft de Douane de reeds afgegeven vergunningen ambtshalve vervangen voor een vergunning op grond van artikel 12 van de Verordening producten voor tweeeërlei gebruik indachtig de resterende looptijd en waarde. Dit heeft eenmalig gevolgen voor de uitvoeringslasten van de Douane.

4. Vast verandermomenten

Deze regeling treedt in werking op 15 november 2025 of werkt in geval van publicatie in de Staatscourant na 14 november 2025 terug tot en met 15 november 2025, de datum van inwerkingtreding van de gedelegeerde verordening. Daarmee wordt in zoverre afgeweken van het kabinetsbeleid inzake vast verandermomenten dat de regeling niet ten minste twee maanden voorafgaand aan dat tijdstip is gepubliceerd. Dit wordt gerechtvaardigd, omdat het de implementatie van een bindende EU-rechtshandeling betreft.

II Artikelsgewijs

Artikel I

De Regeling aanvullende controlemaatregelen op de Verordening producten voor tweeeërlei gebruik wordt in zijn geheel ingetrokken, omdat alle producten in deze regeling via de gedelegeerde verordening zijn opgenomen in Bijlage I van de Verordening producten voor tweeeërlei gebruik. Zie hierover ook het algemeen deel.

Artikel II

De Regeling geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders wordt gewijzigd, omdat een deel van de producten in deze regeling via de gedelegeerde verordening zijn opgenomen in Bijlage I van de Verordening producten voor tweeeërlei gebruik. Hiertoe wordt de bijlage van de Regeling geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders vervangen door een nieuwe bijlage.

Artikel III

Deze overgangsbepaling voorziet in de ambtshalve omzetting van eerder verleende uitvoervergunningen die betrekking hebben op producten die met ingang van 15 november 2025 zijn opgenomen in bijlage I van de Verordening producten voor tweeeërlei gebruik.

De rechtsgrondslag van de voor de inwerkingtreding van deze regeling verleende vergunningen op grond van de Regeling aanvullende controlemaatregelen op de Verordening producten voor tweeeërlei gebruik is met ingang van 15 november 2025 artikel 12 van de Verordening producten voor tweeeërlei gebruik. Dit geldt eveneens voor een deel van de verleende vergunningen op grond van de Regeling geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders. Het gaat daarbij om vergunningen voor geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders, die met ingang van 15 november 2025 zijn opgenomen in bijlage I van de Verordening producten voor tweeeërlei gebruik.

Op de vergunningen voor geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders die met ingang van 15 november 2025 niet zijn opgenomen in bijlage I van de Verordening producten voor tweeeërlei gebruik, maar die nog wel zijn opgenomen in de bijlage, behorend bij de Regeling geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders, is deze overgangsregeling niet van toepassing. Die vergunningen blijven ongewijzigd.



Artikel IV

Zie over de inwerkingtreding en terugwerkende werking van de regeling paragraaf 4 van het algemeen deel.

*De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,
A. de Vries*